

半導体パッケージ基板および高密度電子回路基板用の 感光性フィルムに関する特許権侵害訴訟を提起

株式会社レゾナック（社長：高橋秀仁、以下「当社」）は、レゾナック材料（東莞）有限公司（社長：宇佐美洋）を共同原告として、2023 年 12 月に中国の感光性フィルム製造販売会社である 4 社^{※1}を共同被告として特許権侵害訴訟を深圳市中級人民法院にて提起しました。

本件訴訟は、当社が所有する半導体パッケージ基板および高密度電子回路基板の配線形成等に使用されている感光性フィルムに関する中国特許に基づき、当該被告 4 社が製造販売する感光性フィルムの中国における販売差止と損害賠償を求めるものです。

当社は、今後も事業戦略に沿って知財権を積極的に活用し、知的財産権を法的に保護することで健全な競争を促すとともに、当社技術の価値を高めてまいります。

※1 湖南初源新材料有限公司、湖南瑞鈦新材料科技股份有限公司、深圳市三喜電子線路有限公司、深圳市泰為精密回路有限公司

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023 年 1 月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。半導体・電子材料の売上高は、全体の 3 割にあたる約 4,000 億円に上り、特に半導体の「後工程」で使用される材料を豊富にラインナップしており、多くの半導体関連メーカーに採用されています。

2 社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。

新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistry の「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。

詳しくはウェブサイトをご覧ください。株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス
ブランド・コミュニケーション部 広報グループ
TEL 03-6263-8002